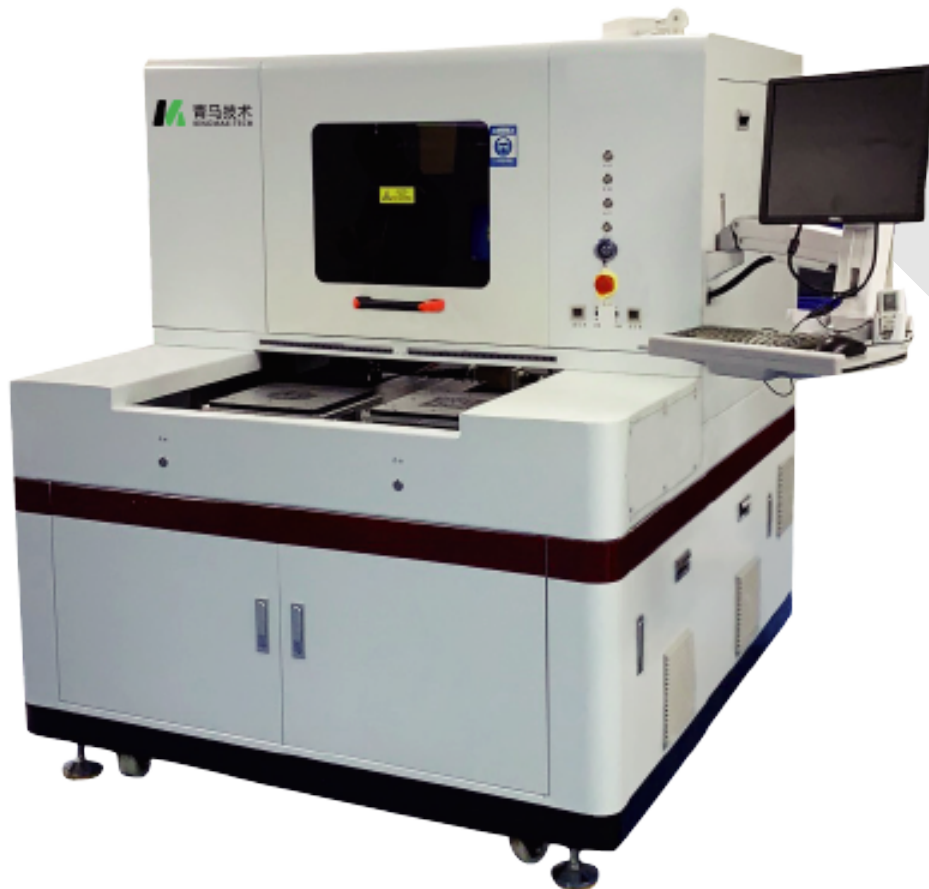


# LD-500&LD-600 离线式激光分板机



- 全花岗岩平台，耐用性极佳；
- 线性马达驱动，高速、低噪音，无振动；
- 线性光栅尺定位，定位精度高达 $\pm 2$ 微米；
- 封闭式光路设计，且内施正压。最大限度保障激光输出功率的稳定性；
- 超大尺寸工作平台；
- 上下双吸尘设计；
- 绿光、紫外两种光源可选；
- 激光线宽小于20微米；
- CCD视觉中心和激光中心同轴，编程简易，操作方便。

## 应用产品及行业

**SMT 行业**—— FPCB、PCBA、软硬结合PCB的分板和钻孔

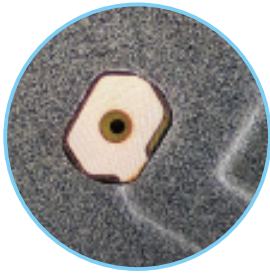
**半导体行业**—— Wafer 微孔、盲孔加工，及Wafer 异形切割

# 设备参数

型号	LD-510	LD-520	LD-530	LD-610	LD-620	LD-630
激光器配置	UV/纳秒/15W	GREEN/纳秒/35W	UV/皮秒/30W	UV/纳秒/15W	GREEN/纳秒/35W	UV/皮秒/30W
平台数量	单工位平台			双工位平台		
平台大小(mm)	550 * 650			350 * 550		
大理石平台平面度(mm)	±0.01			±0.02		
Z轴行程(mm)	100			150		
X/Y平台行程(mm)	750 * 690			850 * 550		
激光器寿命	> 20000小时					
切割方式	扫描头方式, 切割范围50*50mm					
最小聚焦光斑直径	≤20μm					
平台速度	最高速度1000mm/s, 加速度10000mm/s <sup>2</sup>					
平台精度	重复≤±2μm, 定位精度≤±3μm					
机器控制系统软件	LASER STUDIO8 (集成视觉、激光和运动)					
支持文件格式	DXF GEBER G-code 等常见文件格式					
电源	380V/50Hz/5KVA					
环境要求	22°C~25°C					
重量 (kgs)	2000					
外形尺寸 (mm)	1684(W) x 1409(D) x 1775(H)			1560(W) x 1750(D) x 1840(H)		

## 激光切割效果展示

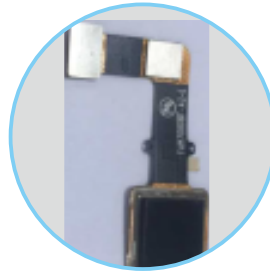
FPCB钻孔效果图



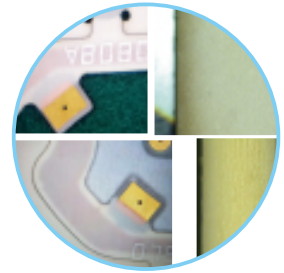
FPCB切割



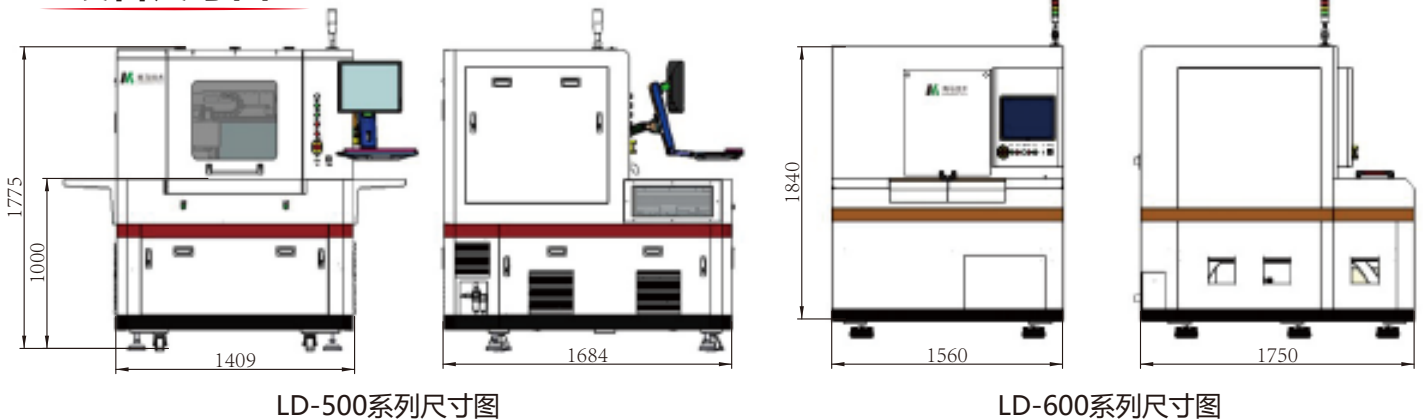
软硬结合PCB切割



LCP切割



## 设备尺寸图



深圳市洋浦实业有限公司

深圳公司: 0755-2782 3996    传真: 0755-2782 3995  
地址: 深圳市宝安区西乡固戍泰华梧桐岛13B2F

<http://www.youngpool.com>

香港电话: 00852-2668 1868    传真: 00852-2668 1899  
地址: 香港九龍尖沙咀漆咸道南45-51號其士大厦803室

- 本产品目录发布日期为2020年6月;
- 本型录所记载的内容, 如因机器改进则有变更的可能, 如需详细了解产品参数, 请事先与洋浦科技或者本公司代理商取得联系;